

## 提升企業價值計畫

## [前言]

半導體產業進入後摩爾時代後，應用場景的發展愈發多元化；另一方面，AI應用的快速發展也使得市場充滿了新的機會。身為利基型記憶體與類比晶片開發為主力的IC設計公司，晶豪科技正面臨著巨大的機遇與挑戰。本計畫旨在透過「技術深化」、「市場擴張」、「營運卓越」與「財務優化」四大策略，將晶豪科技打造成為客戶的最佳夥伴，並提升企業價值、回饋股東。

## [現況分析]

## 一、SWOT 分析

## (一)優勢：

1. 專注於利基型記憶體，避開與一線大廠的正面交鋒。
2. 具備從設計到測試的整合能力，成本控制力佳。
3. 產品線多元，橫跨DRAM、NAND Flash、NOR Flash與類比IC。
4. 對客戶需求反應迅速，服務彈性高。

## (二)劣勢：

1. 研發資源規模相較於國際IDM大廠為小。
2. 在先進製程技術的追趕上面臨壓力。
3. 品牌知名度與國際一線廠商有差距。
4. 對單一供應鏈（如晶圓代工廠）的依賴風險。

## (三)機會：

1. AIoT與邊緣運算興起，對低功耗、小容量的利基型記憶體需求暴增。
2. 電動車與車用電子對各類IC的需求持續成長，門檻高但利潤佳。
4. 5G、網通、工業控制等市場穩定成長。
5. AI應用場景帶動周邊及Edge AI應用的成長。

## (四)威脅：

1. 記憶體市場的景氣循環波動劇烈，影響營運穩定性。

2. 國際大廠可能回頭搶占利基市場。
3. 地緣政治風險導致供應鏈中斷或市場准入問題。
4. 全球性通膨與成本上漲壓力。

## 二、營運情形：

本公司2024年度合併營收新台幣134.85億元，較2023年度成長約13.47%，本期淨利5.05億元，每股獲利1.80元。

2023年初Open AI橫空出世驚艷全球，世界各地充滿對AI熱忱，認為AI的發展將改變未來的生活，紛紛投入大筆的人力和物力開發AI相關產品及其應用；生成式AI及大語言模型(LLM)的研究開發，成為未來幾年各大公司最重要的研究項目；這些研究開發需要用極高的演算能力，不只主晶片需具有高速的運算能力，同時必須搭配高速和高容量的記憶體(HBM)才能有效運行，AI主晶片搭配的HBM記憶體容量以64GB起跳，最高者甚至超過200GB；生成式AI的熱潮將推動未來幾年記憶體需求的大幅成長。但2024年底DeepSeek的出現，可能會大大的改變AI的遊戲規則，運用非常精簡的人力和物力便可產出和Open AI接近相同的結果，大幅降低進入AI領域的門檻，預期將促使AI的發展進入百花齊放的時代，對記憶體的需求將有一番榮景。

為了實現環境永續，電動車將持續維持高成長，可以預期車用半導體的占比會愈來愈高；本公司於2023年底通過ISO 26262安全認證，展現深耕汽車電子的決心，未來幾年在車用半導體的營收可望逐年成長。

在功率IC及類比IC產品線方面，經過多年來的努力及耕耘，產品線越趨於完整，同時亦通過大客戶的驗證，尤其是Audio Amplifier在電視市場的市占比率節節升高。

截至114年前3季，累計營收97.68億元，較113年同期退約5%，本期淨損7.90億元，每股虧損2.81元，然而受惠於DDR4市場供給減少使價格走揚及庫存去化順較，本公司已於9月份起開始轉虧為盈，第3季單季獲利0.14億元，預期未來營運狀況持續改善。

## 三、權益報酬及市場對公司價值評估

### (一) 權益報酬率(ROE)：

本公司2025年前2季ROE為-8.26%，2025年後半年隨著營運狀況改善，第3季轉虧為盈，截至114年前3季，ROE回升至-8.13%，預期ROE可逐步提升。

## (二)市場對公司價值評估：

截至114年9月底，本公司股價淨值比(PBR)由1月低點1.61倍回升至9月高點2.28倍，呈現上升趨勢，隨著公司營運持續改善，投資人對本公司的價值評估亦逐步提高。

# 四、公司治理及永續經營

## (一)董事會結構及獨立性：

本公司於2025年6月完成董事會改選；董事會成員共10位，其中有5位獨立董事(含1位女性董事)，占全體董事比例分別約50%及10%，不具員工身分之董事占比約70%；董事成員具有不同的專業背景，將擁有豐富的專業知識、經營管理及跨產業領域的實務經驗，透過董事會結構的獨立性及多元化，提供公司多面向的觀點和客觀的建議。

## (二)董事會運作之有效性：

本公司定期召開董事會，2024年度共開會7次，董事實際出席率為93%，已於轄下設置審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，以健全董事會監督功能及強化管理機能，每年辦理董事會及功能性委員會的績效評估，以提升其運作之有效性。

## (三)資訊透明度：

本公司秉持誠信透明原則辦理資訊揭露，除依主管機關規定公告、申報及發布重大訊息外，將於中英文公司網站設置投資人關係、企業永續ESG等專區，提供投資人相關資訊。本公司每年二次舉辦法人說明會，向投資人充分說明公司經營績效及未來營運展望。

## (四)ESG成果：

2024年度公司治理評鑑，本公司持續維持排名前20%，展現本公司長期落實永續與透明治理的成果。

## [產業前景]

由於 AI 應用的蓬勃發展，國際 DRAM 大廠產能於主要布局於 HBM 產品，導致 DDR5/DD4 因產能排擠效應的缺貨潮；自 2025 年第 3 季開始後於第 4 季愈演愈烈，相關供應鏈均顯示，記憶體產業近期已經進入「恐慌性備貨」風潮，上游原廠希望觀察供需缺口再提出合約報價，但供應緊缺的消息愈傳愈劇烈，導致缺口愈大、價格漲幅愈大，引發各界瘋狂搶購。尤其網通設備 Switch 受到設計規格固定，DDR4 因短期難以轉換記憶體規格，價格漲幅甚至比同規格 DDR5 來得高，對於企業成本帶來壓力；預期此一利基型記憶體市場的價格調整效應，將陸續擴展到 DDR3/DDR2 等項目。

記憶體搶貨潮已從通路、記憶體模組廠、品牌及系統廠全面展開，隨著 AI 伺服器需求排擠效應加劇，供應鏈緊繃態勢恐將延續至 2026 年，不排除 2027 年仍將持續供應吃緊。

另外，伴隨著運算技術的進步，AI 的應用也逐步由雲端集中運算擴散至終端裝置(Edge Computing)，而使得端點應用的系統對高頻寬、低耗能、低延遲的特性有產生更殷切的需求，造就了客製化 Edge Computing 記憶體，因此預期未來端點 AI 應用可望成為利基型記憶體市場發展的重要範疇。

除了 DDR5 DRAM 缺貨潮延燒，目前 DDR4 市場的狀況是「有貨就拿」，尤其網通設備 Switch 受到設計規格固定，儘管 DDR4 的價格已經比同規格 DDR5 來得高，短期難以轉換記憶體規格，對於企業成本帶來壓力；預期此一市況將因產能排擠效應擴展到 DDR3/DDR2 等項目。

2025 年的電動車市場仍處於佈局與調整階段。車商正在努力鋪設未來的基礎，而市場爆發可能需要等到更多工廠投產、技術進一步突破，以及政策環境更穩定之後才會到來，本公司積極佈署電動車用記憶體市場，隨者電動車市場的爆發將帶動本公司業績成長。

## [未來提升計畫]

### 一、提升策略

## (一) 技術深化與產品差異化

### 1. 聚焦高成長應用領域：

- (1) 擴增研發團隊人員來厚植研發實力及增加研發設備支出，以提升研發效率。
- (2) 擴充25nm/21nm低密度利基型DRAM記憶體產品線，如：DDR4、LPDDR4、DDR3、LP DDR3、DDR2、LP DDR2.. 等。
- (3) 加速19nm DRAM 產品研發，並導入量產。
- (4) 完成19nm/40nm NAND產品量產導入。
- (5) 加速擴充MCP、eMCP and eMMC產品線。
- (6) 全力擴充50nm NOR Flash產品線及業務擴展。
- (7) 擴充車規應用之利基型記憶體產品線。
- (8) 推動研發Edge Computing AI應用之記憶體解決方案
- (9) 加速研發音頻放大器IC及功率IC之產品線。(9)
- (10) 擴充非記憶體產品線，如：IoT/AIoT Wireless IC/Solution, Motor Drive IC, Sensor IC (Temperature/Photo).. 等

### 2. 投入先進製程與封裝：

- (1) 與晶圓代工夥伴緊密合作，將高毛利產品導入更先進的製程以降低成本。
- (2) 發展SiP系統級封裝技術，提供客戶「記憶體+類比IC」的整合解決方案，提升附加價值。

### 3. 強化智財布局：

增加專利申請數量，特別是在電路設計、低功耗技術與封裝結構上，建立技術護城河。

## (二) 市場擴張與客戶深耕

### 1. 深耕現有市場並擴張客戶應用領域：

- (1) 持續擴大現有市場、消費性電子市場的市佔率。
- (2) 設立業務與技術支援據點，就近提供策略客戶有效率的服務。

### 2. 從「元件供應商」轉型為「解決方案提供者」：

- (1) 針對關鍵客戶，提供「參考設計」與「技術套件」，縮短客戶產品上市時間，深化合作關係。
- (2) 建立策略客戶共榮計畫。

### (三)營運卓越與永續發展

#### 1. 供應鏈韌性管理：

- (1) 分散晶圓代工與封測夥伴，降低單一供應鏈風險。
- (2) 因應市場變化建立動態庫存調節機制，以平抑景氣循環帶來的波動。
- (3) 導入AI系統，優化管理效益。

#### 2. 推動ESG永續發展：

- (1) 環境：擬定2030年減碳目標及2030減碳目標、策略及行動計畫，實現環境友善的承諾。
- (2) 社會：打造多元、包容的職場環境。
- (3) 治理：提升董事會成員的多元化與專業性，加強資訊透明度，定期發布ESG報告。

### (四)財務優化與投資人關係

1. 維持穩定的現金股利政策，與股東分享經營成果。
2. 定期舉辦法人說明會，加強與投資人的溝通。
3. 製作英文版企業簡介與年報、ESG報告

## 二、營運計畫

### (一)短期營運計畫

#### (1)行銷策略

- A. 採取產品功能及成本競爭優勢為主的行銷策略，提供客戶穩定之供應量。
- B. 強化與代理經銷商之互動關係，持續深耕國內市場，並積極開發海外市場手持式裝置、PC 週邊設備及資訊家電廠商及電動車廠商，以掌握直接商機。

#### (2)生產策略

- A. 提昇使用製程技術，以降低生產成本。
- B. 與晶圓代工廠及後段封裝、測試外包商建立良好合作關係，以確保產能取得無虞、產品交期與品質，並滿足彈性調度之需求。

#### (3)產品發展

運用新世代的製程技術開發主流產品，以降低生產成本，提昇產品競爭力，並積極布局 Edge AI 應用之記憶體解決方案。本公司也積極擴展其他 IC 設計領域之研發，如 Wireless SOC IC、Motor Driver IC 和 Sensor IC(包含溫度及光感測 IC)等產品，期待在未來 2~3 年內能夠開花結果。

(4) 人力資源

提供人性化管理及透過營運獲利分享員工，以吸引專業人才加入經營團隊並穩定公司人員流動，維持本公司在技術及營運之領先地位。

(5) 公司治理

本公司將持續改善董事會的多元性和獨立性，透過定期評估董事會成員的表現和公司治理實踐情形，以增強董事會對管理層的監督能力。

## (二) 中長期提升計畫

(1) 行銷策略

以具功能/成本競爭力之自有產品及設計技術服務為營收來源，確保獲利績效之穩定。

(2) 生產策略

確保代工夥伴，包括晶圓廠、封裝、測試外包廠之生產品質及週期。

(3) 產品發展

持續開發高集積度、高速度、低功率及 Small Die Size 之記憶體 IC，以增加產品效能，提昇產品競爭力。並運用新世代製程技術，產製現有產品，以強化成本競爭力。另為因應產業發展及市場需求，本公司將積極量產 MCP、類比、類比與數位混合積體電路方面之產品線，朝向產品多元化方向發展。

(4) 企業永續

推動綠色研發和技術創新，加大在綠色技術和永續發展的研發投資，並在產品設計和製造過程中融入環保標準，符合全球節能減排趨勢。本公司將積極善盡企業責任，強化公司治理，提升各項產品核心技術競爭力，打造永續供應鏈，深化客戶互信與夥伴關係，攜手成長，進而持續提升企業價值。